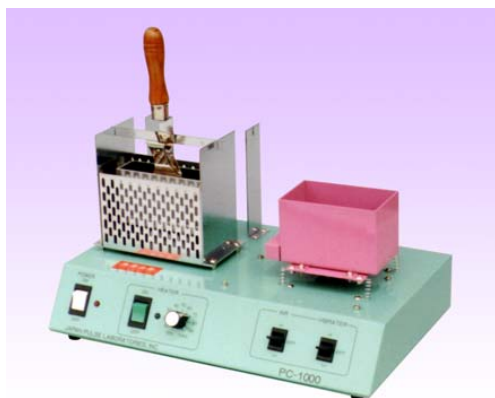


ハイブリッドIC作品例

パウダーコーティング装置 PC-1000

ハイブリッドICの仕上げはエポキシモールドです。PC-1000は小ロットのハイブリッドICや電子部品を、粉体樹脂で均一にコーティングするパウダーコーティング装置です。

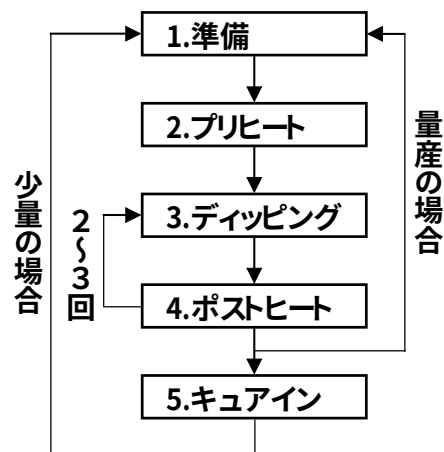
特長

- 本装置はSIP (Single In-line Package) 専用です。
- 1個だけのハイブリッドICを簡単に作ることができます。
- エポキシモールドは強い酸以外には溶けません。回路や部品の防水や秘密保持は万全です。
- (W)90×(D)40×(H)20mmのワークまで、約3分でパウダーコーティングできます。
- 実験試作など小規模生産用の低価格パウダーコーティング装置です。
- この1台でディッピング、プリヒート、ポストヒート及びキュアインとエポキシモールドの全てができます。
- ダイヤフラムポンプ内臓なのでエア源を必要としません。AC電源のみで使用できます。

仕様

- ・流動槽 : (L)94×(W)55×(D)50mm
レベル平面度±0.5mm以下
- ・バイブレーター : 一基
- ・圧縮空気源 : ダイヤフラムポンプ (100g/cm² 0.5ℓ/min)
- ・ヒーター : 150W×2
- ・温度調節範囲 : 100～200℃ アナログ調節
- ・電源 : AC100V ±10% 50/60Hz 300W
(120V/220V/240V仕様もあります)
- ・外形寸法・重量 : (W)350×(D)220×(H)200mm 4.5kg
- ・適合粉体樹脂 : PCE273 日本ペルノックス
7700 ファインポリマーズ
その他ハイブリッドIC用粉体樹脂
- ・適合部品 : ハイブリッドIC基板 (SIP)
Max (W)90×(D)40×(H)20mm
その他防水や秘密保持を必要とする部品
- ・付属品 : ハンドクリップ 1個
整地ヘラ 1個
手袋 1組
ACコード 1本
粉体樹脂 1パック (PCE273 約200ml)
- ・別売消耗品 : SIP用リードピン
粉体樹脂
 - ・黒色 (3kg) PCE-273BL-3kg
 - ・黒色 (5kg) PCE-273BL-5kg

操作手順



※ 量産の場合はポストヒートまで行い、別の乾燥炉でキュアインをしてください。(150℃で1時間)

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。